

宝鼎科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 23 日向招金有色矿业有限公司发行普通股（A 股）股票 26,690,391 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.24 元。截至 2022 年 9 月 23 日止，本公司共募集资金 299,999,994.84 元，扣除发行费用 13,911,972.06 元，募集资金净额 286,088,022.78 元。

截止 2022 年 9 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所以“中天运[2022]验字第 90052 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况及余额情况如下：

项目	金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	108,454,369.10
加：募集资金银行存款利息收入(扣除手续费)	324,600.76
减：本年补充流动资金	78,605,222.40
本年支付中介机构费用	
本年支付募投项目款项	18,147,366.28
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额	12,026,381.18

截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金累计投入 296,931,256.56 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；于 2022 年 9 月 23 日起至 2025 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 296,931,256.56 元；本年度使用募集资金 96,752,588.68 元。截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 12,026,381.18 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2025年第五届第二十五次董事会审议通过，并业经本公司2025年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“浙商银行杭州西湖支行”）开设募集资金专项账户3310010610120100216175，并于2022年10月19日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）、浙商银行杭州西湖支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子公司”）在中国工商银行股份有限公司招远支行（以下简称“工商银行招远支行”）开设募集资金专用账户1606021729200238706，并于2023年7月19日与本公司、工商银行招远支行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行监管协议进程中不存在问题。

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的20%的，公司应当以书面形式知会独立财务顾问主办人。截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浙商银行股份有限公司 杭州西湖支行	331001061012010021617 5	285,999,994.84	75,930.12	活期
中国工商银行股份有限公司 招远支行	1606021729200238706		11,950,451.06	活期
合计		285,999,994.84	12,026,381.18	

三、2025年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，并于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过，将“7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔”募投项目投资规模进行调减，由年产7,000吨减少到2,000吨，项目总投资由66,567.99万元减少到25,700.00万元，其中募集资金投入由25,000.00万元减少到18,000.00万元，其余7,700.00万元为金宝电子自筹资金投入。公司将调减后结余募集资金7,000.00万元及利息永久补充流动资金。具体情况详见本核查意见“附表二:变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月21日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：宝鼎科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		299,999,994.84			本年度投入募集资金总额		96,752,588.68			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		296,931,256.56			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.金宝电子“2,000吨/年高速高频板 5G 用(HVLP)铜箔项目”	是	250,000,000.00	180,000,000.00	18,147,366.28	168,326,039.32	93.51		【注】		是
2.补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	是	49,999,994.84	119,999,994.84	78,605,222.40	128,605,217.24	107.17		不适用		否
承诺投资项目小计		299,999,994.84	299,999,994.84	96,752,588.68	296,931,256.56	98.98				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	2024年8月22日及9月12日,公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目投资规模及永久补充流动资金的议案》,将募投项目规模从年产7,000吨减少到2,000吨,总投资规模从6.65亿减少到2.57亿,其中配套募集资金从2.5亿减少到1.8亿;并将结余募集资金及利息永久补充流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	市场环境发生较大变化,2021至2023年,我国电子铜箔产能迅速增长超过下游电子行业需求增长。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2024年4月10日,公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司将募投项目由招远市金宝电子材料产业基地内(招远市国大路268号)变更至山东省烟台市招远市开发区金晖路229号,详见《关于变更募投项目实施地点的公告》(公告编号:2024-031)。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	调减募投项目投资规模后，将结余募集资金 7,000.00 万元（不包含利息）									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									
募集资金总额	299,999,994.84				本年度投入募集资金总额			96,752,588.68		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额			296,931,256.56		
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.金宝电子“2,000吨/年高速高频板 5G 用(HVLP)铜箔项目”	是	250,000,000.00	180,000,000.00	18,147,366.28	168,326,039.32	93.51		【注】		是
2.补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	是	49,999,994.84	119,999,994.84	78,605,222.40	128,605,217.24	107.17		不适用		否
承诺投资项目小计		299,999,994.84	299,999,994.84	96,752,588.68	296,931,256.56	98.98				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	2024 年 8 月 22 日及 9 月 12 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目投资规模及永久补充流动资金的议案》，将募投项目规模从年产 7,000 吨减少到 2,000 吨，总投资规模从 6.65 亿减少到 2.57 亿，其中配套募集资金从 2.5 亿减少到 1.8 亿；并将结余募集资金及利息永久补充流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	市场环境发生较大变化，2021 至 2023 年，我国电子铜箔产能迅速增长超过下游电子行业需求增长。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2024 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目由招远市金宝电子材料产业基地内（招远市国大路 268 号）变更至山东省烟台市招远市开发区金晖路 229 号，详见《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-031）。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	调减募投项目投资规模后，将结余募集资金 7,000.00 万元（不包含利息）									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注: 因金宝电子“2,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目”于2024年12月达到预定可使用状态, 2025年度高速高频板5G用(HVLP)铜箔处于试生产阶段, 尚未产生效益。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宝鼎科技股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
金宝电子“2,000吨/年高速高频板 5G用(HVLP)铜箔项目	金宝电子“7,000吨/年高速高频板 5G用(HVLP)铜箔项目	180,000,000.00	18,147,366.28	168,326,039.32	93.51		【注】		否
补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	119,999,994.84	78,605,222.40	128,605,217.24	107.17		不适用		否
合计		299,999,994.84	96,752,588.68	296,931,256.56	98.98	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目投资规模及永久补充流动资金的议案》。公司拟将募投项目从年产 7,000 吨减少到 2,000 吨，总投资规模从 6.65 亿减少到 2.57 亿，其中配套募集资金从 2.5 亿减少到 1.8 亿						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注：因金宝电子“2,000吨/年高速高频板 5G用(HVLP)铜箔项目”于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，2025 年度高速高频板 5G 用（HVLP）铜箔处于试生产阶段，尚未产生效益。